

中信证券股份有限公司

关于

广东德聚技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受广东德聚技术股份有限公司（以下简称“德聚技术”、“发行人”或“公司”）的委托，担任德聚技术首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构。

中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中的简称释义如无特别说明，均与《广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。

目 录

声 明.....2

目 录.....3

一、发行人基本情况.....4

二、发行人本次发行情况.....20

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....21

四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明.....22

五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见.....23

六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项.....26

七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明.....27

八、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的说明.....27

九、保荐人关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》上市条件的说明.....33

十、持续督导期间的工作安排.....34

十一、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式.....35

十二、保荐人关于本项目的推荐结论.....35

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

公司名称	广东德聚技术股份有限公司
英文名称	Guangdong CollTech Technology Co., Ltd.
注册资本	7,340.70 万元
法定代表人	黄成生
有限公司成立日期	2016 年 5 月 5 日
股份有限公司成立日期	2023 年 5 月 30 日
公司住所	广东省东莞市石排镇向沙路石排段 14 号
邮政编码	523331
联系电话	0769-89066909
传真	0769-89066901
互联网网址	http://www.colltechgroup.cn
电子信箱	ir@colltech.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	证券事务部
董事会秘书	姚进
联系电话	0769-89066909
业务范围	产销、加工、设计开发：胶接剂（不含危险化学品）、电子辅料、点胶设备、表面处理设备、紫外光固化设备；国际、国内货物运输代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型	首次公开发行 A 股股票并在创业板上市

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

1、主营业务情况

公司是一家专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售的国家重点“小巨人”企业，主要产品为电子胶粘剂，并围绕客户具体用胶场景提供配套应用方案，已形成覆盖智能终端、新能源、半导体、通信等领域的产品布局。

电子产品需要在有限空间里实现高效协作，芯片、电子元器件、线路板、功能模组及结构件等构成了它的主体，电子胶粘剂则是贯穿其间的“无形纽带”，使不同材料、器件和结构在长期运行中保持稳定配合。电子胶粘剂在电子产品中承担可靠连接、功能防护和性能承载等职责，在微小空间内实现连接、防护、导

热散热、导电绝缘、应力缓冲等功能，并由此直接影响着终端产品生产良率、运行可靠性和使用寿命。随着下游终端产品向轻薄化、小型化、高集成度、高功率密度和高可靠性方向发展，电子胶粘剂已成为保障关键电子材料的供应链安全的重要基础材料之一。

公司已在多个电子制造场景形成代表性产品成果，原创开发的柔性电路板（FPC）用元器件包封胶，通过光热双固化体系和低模量配方设计，实现快速定位、深层固化、高电绝缘、低应力及柔韧性的平衡，保障消费电子产品电性能的长期稳定，已在苹果等多个知名终端品牌商的智能终端产品中实现规模化应用；公司自主研发的磁芯粘接胶，适配磁芯材料与 PCB 之间的功能性粘接及 SMT 回流固化工艺，兼具高粘接强度、柔韧性和车规级高可靠性，成为特斯拉指定供应商。在此基础上，公司持续向芯片级封装等高附加值用胶场景拓展，是国内少数实现芯片级底部填充胶在倒装芯片（Flip Chip）封装等先进封装工艺中产业化应用的厂商，并具备芯片固晶胶膜（DAF）、各向异性导电胶膜（ACF）等高端半导体膜材开发能力，为公司进一步完善产品矩阵和后续产业化转化提供了充足的产品储备。

公司坚持自主研发和技术创新，围绕电子胶粘剂原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化及产业化应用持续投入，已形成以丙烯酸酯、环氧树脂、有机硅、聚氨酯、改性硅烷、杂化等为基础的六大化学体系产品平台。截至本上市保荐书出具日，公司已获发明专利授权 65 项、实用新型专利授权 49 项。公司荣膺工业和信息化部新一轮第一批国家重点“小巨人”企业及第三批专精特新“小巨人”企业，经广东省科学技术厅认定为“广东省新型高端电子胶粘剂（德聚）工程技术研究中心”，经广东省工业和信息化厅认定为“第 22 批省级企业技术中心”和“2024 年广东省省级制造业单项冠军企业-丙烯酸电子胶粘剂”。

凭借产品性能、质量稳定性、技术响应能力及持续供货能力，公司已进入多家下游知名客户的供应链体系，业务遍及亚洲、美洲及欧洲，并在部分应用场景与汉高、陶氏化学、3M、富乐、德路等国际厂商直接竞争。报告期内，公司主要向东山精密、鹏鼎控股、立讯精密、安费诺、旗胜电子、Sanmina、台郡科技、和硕、富士康等全球知名电子制造厂商直接供货，产品最终应用于苹果、特斯拉、OPPO、华为、阳光电源、比亚迪、vivo、小米、三星、宁德时代等知名终端品

牌商或其产业链客户，形成了覆盖智能终端、新能源、半导体、通信等领域的规模化应用能力。此外，公司围绕芯片封装、光模块、AI 服务器等高附加值用胶场景推进产品导入和客户拓展，已陆续通过卓胜微、通富微电、舜宇光学、中际旭创、MPS、恒诺微等客户的产品验证测试。随着终端产品迭代、先进封装自主配套加速及新兴算力基础设施建设等需求提升，公司将持续拓宽产品矩阵和应用边界，推动技术积累向规模化收入转化。

2、核心技术情况

经过多年自主研发，公司形成共计 20 项核心技术，覆盖丙烯酸酯、环氧树脂、有机硅、聚氨酯、改性硅烷、杂化六大化学材料体系和智能终端、新能源、半导体、通信四大战略性新兴产业。

公司核心技术已建立完善的保护体系，除部分因技术保密原因或尚处于送样阶段未申请专利，其余核心技术均已形成或正在申请对应的专利，具体情况如下：

序号	核心技术名称	专利名称	专利号
1	UV 湿气双重固化丙烯酸酯预聚物合成技术	一种用于电子元器件的 UV 湿气双重固化的胶粘剂	ZL202211242943.6
		一种改性丙烯酸酯低聚物及一种 UV、湿气双重固化压敏胶	ZL202110157365.5
		一种耐油酸 UV-湿气双重固化胶粘剂	ZL202211336181.6
2	高性能反应型聚氨酯产品制备技术	一种湿气固化型聚氨酯热熔胶	ZL202110157562.7
		一种紫外光和湿气双重固化聚氨酯热熔胶及其制备方法	ZL201911420848.9
		一种低水汽透过率湿气固化型聚氨酯热熔胶	ZL202310204493.X
3	半导体胶膜核心树脂合成技术	一种耐高温、抗变形芯片环氧胶膜及其制备方法	ZL202311007128.6
4	UV 延迟固化环氧树脂材料制备技术	非专利技术	
5	光热双固化高性能元器件包封胶配方开发技术	一种光/热双固化低介电性能胶黏剂及其制备方法	ZL202010097655.0
		一种低吸水率的丙烯酸胶黏剂及其制备方法	ZL202211242278.0
6	耐高温高湿环氧胶黏剂复配技术	一种用于晶圆级芯片尺寸封装的底部填充胶组合物及其制备方法	ZL202210746333.3
		一种耐高温环氧胶黏剂及其制备方法	ZL202110284056.4
7	硅烷改性聚醚密封胶制备技术	一种改性端硅烷聚醚密封胶及其制备方法	ZL202110156574.8
		一种多粘接功能的硅烷改性聚醚密封胶及其制备方法	ZL202310170687.2

序号	核心技术名称	专利名称	专利号
8	低温快速固化单组份胶黏剂配方开发技术	一种低温快速固化耐湿热环氧粘结剂及其制备方法和应用	ZL202210746391.6
9	球形填料复配及倒装芯片封装底部填充胶组合制备技术	一种用于晶圆级芯片尺寸封装的底部填充胶组合物及其制备方法	ZL202210746333.3
		一种耐高温环氧胶黏剂及其制备方法	ZL202110284056.4
		一种适用于智能汽车的底填胶及其制备方法	ZL202211621219.4
		一种高流淌性低热膨胀系数的底填胶水及其制备方法	ZL202211575925.X
10	高 Tg 低 CTE 树脂开发和改性填料互配技术	一种抗冲击 UV 固化围堰胶及其制备方法	ZL202211242271.9
11	高性能导热界面材料配方优化技术	一种耐湿热聚氨酯导热结构胶及其制备方法	ZL202310563912.9
		一种低密度阻燃型导热聚氨酯结构胶及其制备方法	ZL202211575966.9
12	低硬度镍碳系列导电屏蔽胶制备技术	一种低硬度点胶成型屏蔽导电胶及其制备方法和应用	ZL201110383570.X
13	低沉降耐高温环氧电磁屏蔽涂料的制备技术	一种环氧电磁屏蔽涂料及其制备方法	ZL202110267675.2
		一种耐高温电磁屏蔽涂料及其应用	ZL202110269248.8
14	高性能芯片级导电胶黏剂优化设计与开发技术	一种耐高低温单组分半导体用导电胶及其制备方法	ZL202210935121.X
		一种耐湿热环氧导电胶、制备方法及其应用	ZL202210746332.9
		一种低温半烧结导电导热胶及其制备方法	ZL202111411475.6
		一种用于芯片封装材料的银粉填充体筛选方法	ZL202111068664.8
		一种应用于大尺寸芯片粘接的导电胶及其制备方法	ZL202110980035.6
		一种适用于不同属性芯片封装材料的原料预处理工艺	ZL202111069101.0
15	半导体封装保护固晶胶膜的配方开发技术	一种耐高温、抗变形芯片环氧胶膜及其制备方法	ZL202311007128.6
16	模组封装 AA 制程胶光热双重固化胶黏剂制备技术	一种用于摄像头模组的光热双重固化胶黏剂及其制备方法	ZL202311194066.4
17	加成型有机硅增粘剂结构设计及双组份加成固化有机硅的制备技术	非专利技术	
18	各向异性导电胶膜及其原材料制备技术	膜体材料及应用该材料的导电性粘贴膜	ZL2024107608242
19	水性可喷涂高绝缘导热涂层技术	非专利技术	

序号	核心技术名称	专利名称	专利号
20	基于导电硅胶的高可靠晶振胶技术	一种应用于晶体振荡器的有机硅热固化纯银导电胶及制备方法	专利申请中

3、发行人核心技术的先进性表征

电子胶粘剂行业的技术难度主要体现在多种性能要求及量产工艺约束之间实现平衡。电子胶粘剂除了需要包括传统胶粘剂的粘接、密封、灌封和涂覆作用，即粘接强度、硬度、密封性、韧性、抗跌落失效等性能，还需具备导热、介电、绝缘、电磁屏蔽、耐电压、耐腐蚀、吸水或疏水、阻燃、尺寸稳定、光学性能、耐冷热冲击等特殊性能。该部分性能指标的单一优化通常较为容易，但多种指标之间往往并不兼容，例如物体很难同时兼备硬度和柔韧性。因此，如何通过原材料开发与修饰、产品配方设计和生产工艺优化，在多性能约束下形成平衡、稳定、可量产的解决方案，满足下游应用点的特殊需求，同时兼顾客户应用电子胶粘剂时的生产效率、点胶成本和固化条件等，即为电子胶粘剂设计开发的技术难度。

公司主营产品电子胶粘剂的核心技术包括原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化等方面。

原材料是电子胶粘剂性能突破的关键技术门槛，开发难度较大，尤其是核心成分的分子结构设计及合成制备技术是电子专用高分子材料领域的底层技术，需要完善的高分子聚合物理论支撑及大量的实验测试才能完成。公司拥有配方核心成分的分子结构设计及合成制备技术，已建立丰富的核心成分分子结构储备，对各类成分的性能指标可实现精准把控，并在此基础上通过对各组分进行配方复配，满足不同下游领域对电子胶粘剂不同的综合性能需求。

配方的细微变化对产品综合性能的实现有着重要影响。电子胶粘剂主体成分包含树脂、填料、交联剂、增韧剂、固化剂、催化剂、抑制剂、增粘剂、触变剂等多种主剂及助剂成分，各成分在产品配方中所扮演的角色亦有所不同。公司经大量实验测试，验证不同成分组合的复配工艺所形成的产品性能特征，并持续优化产品配方及生产工艺，筛选确定适配的原材料组合及配比关系，以实现产品多项性能之间的平衡及精确调整，实现针对性、定制化的配方及工艺开发。

经过多年自主研发，公司形成共计 20 项核心技术，核心技术先进性的具体情况如下表所示：

序号	核心技术名称	技术研发背景	技术独特性和突破点	应用领域及产品	技术水平情况	技术来源	技术成熟度
1	UV 湿气双重固化丙烯酸酯预聚物合成技术	智能终端等精密电子组装中，大量不透明基材、窄缝异形结构需兼顾 UV 快速定位与盲区湿气固化，常规双重固化产品普遍存在韧性不足、易跌落失效、耐化学性差等痛点，无法满足高可靠性组装要求，亟需开发综合性能均衡的相关技术	该项技术解决固化盲区问题；突破固化效率与韧性不可兼得的行业痛点，兼顾高粘接强度、优异柔韧性与抗冲击性，同时优化耐化学性与生物相容性	智能终端-手机、手表；新能源汽车-CCS 系统	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
2	高性能反应型聚氨酯产品制备技术	电子制造自动化产线对效率要求持续提升，传统胶粘剂无法兼顾快速定位与高强度粘接，常规 PUR 产品存在初粘力不足、开放时间不可控的缺陷，大幅制约产线流转效率，亟需开发适配高端自动化产线的高性能 PUR 制备技术	该项技术合成互穿聚合物网络结构预聚物，实现开放时间宽范围可控；压合 5 分钟即可形成 0.6-2.2MPa 高强度粘接，无需夹具即可产线连续流转，显著提升生产效率，兼具多基材适配性与高可靠性	智能终端-手机、手表盖板粘接密封	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
3	半导体胶膜核心树脂合成技术	半导体先进封装向晶圆级、3D 堆叠方向快速演进，传统液态固晶胶无法适配超薄芯片均匀粘接需求，DAF 核心树脂技术长期被海外厂商垄断，国产化率较低，亟需开发能够实现自主保障的半导体胶膜核心树脂合成技术	该项技术突破高分子量与低 Tg 不可兼得的技术难题，胶膜常温贴装柔韧性优异、高温下尺寸稳定性强；实现 Tg、模量、CTE 精准调控，固化后增韧效果与可靠性突出	半导体芯片粘接固定	公司应用该核心技术的产品性能指标已接近行业领先水平	自主研发	小批量
4	UV 延迟固化环氧树脂材料制备技术	高精密组装工序对微米级对位精度要求严苛，传统 UV 胶无对位调整窗口，易造成产品报废，常规双重固化体系成本高、工艺复杂，核心技术长期被海外巨头垄断，亟需开发 UV 延迟固化技术	该项技术构建分步固化体系，UV 光照后可提供 1-3 分钟可控对位窗口，解决固化速度与精密对位不可兼得的行业痛点；完全固化后剪切强度达 7.9MPa，冷热循环后仍保持高粘接性能	智能终端结构粘接和密封	UV 延迟固化技术目前全球仅汉高、德路、日本积水化学等海外巨头厂商掌握相关核心技术，公司已在该领域实现前沿技术开发	自主研发	送样

序号	核心技术名称	技术研发背景	技术独特性和突破点	应用领域及产品	技术水平情况	技术来源	技术成熟度
5	光热双固化高性能元器件包封胶配方开发技术	柔性电子产业快速发展，FPC 元器件包封需同时满足低硬度高柔韧、高绝缘低透水、强粘接耐湿热的多重要求，常规包封胶普遍存在性能失衡问题，无法适配柔性电子长期可靠性要求	该项技术构建光热双固化体系，兼顾快速定位与深层固化；突破柔韧性与绝缘性不可兼得的行业痛点，低硬度适配 FPC 弯折场景，双 85 环境下稳定工作 1,000 小时，绝缘阻抗稳定在 $1.0 \times 10^9 \Omega$ 以上，核心指标处于行业领先水平，已批量规模化应用。通过使用低敏感单体降低丙烯酸体系的刺激性，满足终端的一类环保管控，产品低模量进一步降低固化应力，提高温冲的可靠性，同时绝缘性能也进一步升级	智能终端-手机、手表；新能源汽车-CCS 系统	公司应用该技术设计的元器件包封胶，已成为公司主力产品，关键性能指标处于行业领先水平	自主研发	批量
6	耐高温高湿环氧胶粘剂复配技术	新能源汽车电子快速发展，车载 BMS、电芯模组用 FPC 对胶粘剂提出车规级高可靠性要求，消费电子级胶粘剂耐湿热性能不足，传统环氧胶高温回流焊后性能衰减、良率低，无法适配车载场景严苛要求	该项技术构建填料-固化剂协同体系，显著提升树脂耐湿热与高温稳定性；引入特种增韧材料，兼顾高 Tg 与较低的高温模量，解决高温回流焊后性能衰减的行业痛点，双 85 测试后对 PI 基材粘接强度仍超 5MPa	新能源汽车-CCS 系统	公司该系列产品性能指标处于行业领先水平	自主研发	批量
7	低温快速固化单组份胶粘剂配方开发技术	半导体、医疗电子等领域大量热敏性元器件与非透明基材，无法适配高温固化与 UV 光固化工艺，常规低温固化胶存在固化慢、储存稳定性差、粘接强度不足的缺陷，无法兼顾低温固化与高可靠性需求	该项技术构建潜伏性固化体系，低温下可快速固化，常温下储存稳定性优异，解决热敏性元器件固化适配难题；通过树脂与填料协同复配，兼顾高粘接强度、低模量与耐湿热性能，抗跌落性能突出	智能终端结构粘接	公司该款产品粘接强度等指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
8	硅烷改性聚醚密封胶制备技术	新能源、智能终端等领域工程塑料构件的粘接密封，对密封胶提出高本	该项技术优化硅烷封端聚醚分子结构，固化后形成高密度交	智能终端和新能源	公司该系列产品性能指标已	自主研发	批量

序号	核心技术名称	技术研发背景	技术独特性和突破点	应用领域及产品	技术水平情况	技术来源	技术成熟度
		体强度、多基材适配、高耐候性的综合要求，传统硅橡胶密封胶对PA/PC/ABS等塑料粘接性差、强度低，易出现密封失效问题	联网络，本体强度与拉伸性能显著提升；主链引入丙烯酸酯结构增强韧性，通过偶联剂复配实现多基材广谱粘接，固化后粘接与拉伸强度均达 3MPa 以上，断裂延伸率达 100%以上	汽车结构粘接密封	达到国际同行同等水平		
9	高 Tg 低 CTE 树脂开发和改性填料互配技术	BGA 封装芯片边角绑定工序，对材料提出高粘接、低应力、高尺寸稳定性的要求，常规丙烯酸 UV 胶对 PCB 阻焊层粘接性差，易脱落失效，传统材料热膨胀系数高，易挤压损伤芯片焊点，亟需适配的高性能绑定材料技术。	该项技术开发高 Tg 低 CTE 特种树脂体系，固化后 Tg 达 120°C 以上，CTE 小于 30ppm/K，高温尺寸稳定性优异，解决热应力损伤焊点的行业痛点；通过改性填料复配，兼顾高固化深度、优异柔韧性与强粘接性能，抗振动跌落效果突出	芯片底部填充	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
10	球形填料复配及倒装芯片封装底部填充胶组合制备技术	倒装芯片封装成为高端芯片主流技术路径，底部填充胶需适配微米级间隙快速填充，同时满足低 CTE、高 Tg、高耐候性的严苛要求，高端产品核心技术长期被海外厂商垄断，亟需能够实现自主保障的相关技术	该项技术构建微纳米球形硅微粉梯度复配体系，显著提升胶体流动性与微米级间隙无孔洞填充能力；通过特种环氧树脂改性，固化后 Tg 达 155°C，CTE 低至 25ppm/K，剪切强度达 40MPa，耐冷热循环性能优异	芯片底部填充	公司应用该核心技术的产品性能指标已接近行业领先水平	自主研发	小批量
11	高性能导热界面材料配方优化技术	高功率芯片热管理需求持续升级，传统导热界面材料存在热阻高、长期易老化出油、工艺适配性差的痛点，高端芯片级 TIM 材料长期被海外厂商垄断，亟需开发兼顾高导热、高可靠性、优工艺性的高性能 TIM 技术	该项技术构建多粒径梯度导热网络，产品导热系数达 4.5W/m·K，热阻低至 0.1°C·cm²/W，接近行业领先水平；优化耐老化体系，大幅降低析油性，保障长期散热稳定；挤出速率达 60g/min，适配自动化高速点胶工艺	芯片和电路板散热	公司应用该核心技术的产品性能指标已接近行业领先水平	自主研发	批量

序号	核心技术名称	技术研发背景	技术独特性和突破点	应用领域及产品	技术水平情况	技术来源	技术成熟度
12	低硬度镍碳系列导电屏蔽胶制备技术	电子设备高集成化、高频化发展，电磁干扰问题日益突出，传统屏蔽材料无法适配紧凑异形空间，常规屏蔽胶硬度高、易磨损设备、高低温循环后屏蔽性能衰减，核心技术长期被海外厂商垄断，亟需能够实现自主保障的低硬度高性能屏蔽胶技术	自主研发核心制备技术，构建镍碳复合导电体系，老化前后屏蔽隔离度均大于 70dB；通过柔性树脂体系设计实现低硬度特性，减少设备磨损，同时适配异形弯折场景；可通过 -40°C~125°C 的 1,000 次高低温循环测试，性能稳定	电磁屏蔽	该款产品早期被诺兰特（Nolato）垄断，目前公司已掌握该领域核心技术，成为国内主要厂商之一	自主研发	批量
13	低沉降耐高温环氧电磁屏蔽涂料的制备技术	半导体元器件微型化发展，传统硬质屏蔽材料无法适配 0.1mm 级微型元器件精细化屏蔽需求，常规屏蔽涂料存在填料易沉降、耐高温性差、喷涂工艺性不佳的痛点，易出现屏蔽失效、涂层脱落等问题	该项技术通过导电填料表面改性解决沉降难题，储存稳定性优异，触变指数小于 1.5，适配微米级精密喷涂工艺；耐高温性能突出，可承受 3 次以上高温回流焊无粘接失效，体积电阻率小于 $0.1\Omega \cdot \text{cm}$ ，双 85 环境下 1,000 小时老化后性能稳定，已完成小批量试制	电磁屏蔽	公司该系列产品性能指标已接近国际同行同等水平	自主研发	小批量
14	高性能芯片级导电胶粘剂优化设计与开发技术	半导体封装微型化发展，芯片级导电胶需适配 50 微米级间隙粘接，同时满足低电阻率、高耐湿热、优流动性的严苛要求，常规产品存在湿热环境下导电性能衰减、工艺适配性差的痛点，高端产品长期被海外厂商垄断	该项技术通过导电粉体纳米改性，提升与树脂相容性，在高填充下仍保持优异流动性，适配微米级精密封装；构建稳定三维导电网络，双 85 环境 1,000 小时测试后，仍保持 $1.0 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$ 量级极低电阻率，同时兼具高粘接强度与耐候性	半导体芯片粘接	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
15	半导体封装保护固晶胶膜的配方开发技术	3D 堆叠、Chiplet 等先进封装快速发展，DAF 作为芯片立体堆叠的核心材料，需实现 Tg、模量、CTE 三大核心参数精准平衡，核心配方与制备技术长期被海外厂商垄断，国产化率较低，	该项技术实现 Tg、模量、CTE 三大参数精准协同调控，热压贴装可实现微米级均匀涂覆与高精度贴装，高温下尺寸稳定性优异，有效抑制芯片翘曲分	半导体芯片粘接	公司该系列产品性能指标已接近行业领先水平	自主研发	小批量

序号	核心技术名称	技术研发背景	技术独特性和突破点	应用领域及产品	技术水平情况	技术来源	技术成熟度
		亟需能够实现自主保障的 DAF 配方开发技术	层；固化后剥离强度达 300g/25mm，剪切强度超 8MPa，耐候性与可靠性突出				
16	模组封装 AA 制程胶光热双重固化胶粘剂制备技术	光学模组向高像素、高精度升级，AA 制程需胶粘剂实现“先临时精准定位、后永久高强度锁固”，传统单一固化胶无法适配工艺需求，核心技术长期被海外厂商垄断，国产化率较低，亟需开发 AA 制程专用胶粘剂技术	该项技术构建光热双分步固化体系，UV 光照 1-5 秒即可快速初步定位，保证部件无位移，同时保留微米级调校窗口；80~85℃低温加热即可完成完全固化，形成高稳定粘接强度，耐候性与抗冲击的优异性能	摄像头模组结构粘接	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
17	加成型有机硅增粘剂结构设计及双组份加成固化有机硅的制备技术	Mini/Micro LED 产业爆发式增长，传统缩合型有机硅固化释放副产物易腐蚀微电极，常规加成型有机硅存在固化深度不足、易黄变、透光率衰减的痛点，无法满足新型显示面板长期可靠性要求	该项技术设计合成新型加成型有机硅增粘剂，提升多基材粘接性能，大幅优化固化深度与固化效率；通过树脂改性提升折射率与出光效率，优化抗黄变体系，长期老化后透光率仍保持 92%以上，有效抑制光衰，适配 Mini/Micro LED 光学保护需求	Mini LED 的保护	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
18	各向异性导电胶膜及其原材料制备技术	新型显示产业高密度互连需求持续升级，ACF 是显示面板与驱动芯片绑定的核心关键材料，全链条核心技术长期被日本厂商垄断，亟需开发能够实现自主保障的 ACF 全链条技术	该项技术自主构建 ACF 从原材料合成、配方设计到精密涂布的全链条自主研发体系；实现胶膜“垂直导通、水平绝缘”的精准各向异性导电特性，解决高密度互连短路风险；掌握微米级超薄胶层均匀涂布核心工艺	显示屏驱动芯片与电路板连接固定	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
19	水性可喷涂高绝缘导热涂层技术	新能源汽车产业快速发展，车内电控系统电子元件高度集成，热量累积易影响系统稳定性与安全性，传统绝缘	该项技术以水为溶剂制备环保型涂层，乳化环氧树脂搭配导热填料，实现超声喷涂下涂层	新能源汽车电控系统	公司该系列产品性能指标处于行业领先水	自主研发	批量

序号	核心技术名称	技术研发背景	技术独特性和突破点	应用领域及产品	技术水平情况	技术来源	技术成熟度
		胶膜散热能力不足，无法适配车载电控系统高绝缘、高导热的双重严苛要求，亟需开发新型散热绝缘材料技术	均匀致密；导热系数达 2W/(m·K)，兼具高附着力与高绝缘性，可通过 125°C/2,000h 耐高温、双 85、耐盐雾及 4.3KV 耐击穿电压等车规级严苛可靠性测试，环保性与综合性能兼具		平		
20	基于导电硅胶的高可靠晶振胶技术	晶振行业用导电银胶核心技术长期被海外厂商垄断，国产化率极低；有机硅本体极性低，对金、银基材粘接性差，且导电填料添加量易造成“导电性提升则粘接性、模量失衡”的行业痛点，亟需开发兼顾高导电、低模量、高粘接力与低 VOC 的晶振专用导电胶技术	该项技术通过低真空高温薄膜蒸发降低原料 VOC 含量，保障晶振 ppm 级精度长期工作；优化基础树脂流变性与力学性能，复配适配银粉及有机硅体系特种助剂，实现对镀金基材的高粘接；精准平衡高导电性、低模量特性，规避胶层脱落风险，跌落特性测试寿命高于同类型国内外产品	半导体晶体振荡器件的导电粘接	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量

注：上表中所列示的粘接强度数据均为基于客户要求的基材进行测试的数据。

（三）发行人主要经营和财务数据及财务指标

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	4.81	2.62	5.36
速动比率（倍）	4.56	2.47	5.11
资产负债率（母公司）（%）	19.74	19.68	14.59
资产负债率（合并）（%）	24.74	25.89	22.41
利息保障倍数（倍）	43.10	14.44	19.15
主要财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次）	3.06	2.63	2.49
存货周转率（次）	3.35	3.47	3.05
息税折旧摊销前利润（万元）	18,636.11	12,341.89	8,087.84
归属于母公司股东净利润（万元）	12,783.97	7,164.96	4,466.50
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润（万元）	12,457.28	7,724.90	4,335.45
研发投入占营业收入的比例（%）	14.85	18.02	16.94
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.97	1.47	0.91
每股净现金流量（元）	0.30	-3.10	-0.17
每股净资产（元）	13.57	11.75	10.72

注 1：上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

利息保障倍数=（净利润+所得税费用+利息支出）/利息支出

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧摊销

研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

每股净资产=归属于母公司股东净资产/期末总股本

（四）发行人存在的主要风险**1、与发行人相关的风险****（1）经营风险****1) 客户集中风险**

报告期各期，公司前五大客户销售收入合计分别为 18,217.34 万元、19,808.81 万元及 25,310.75 万元，占当期营业收入总额的比例分别为 51.84%、51.47%及

55.28%，占比相对较高。同时，公司产品对应的终端品牌商较为集中，主要包括苹果、特斯拉、OPPO、华为及阳光电源等，若未来公司与主要直接客户或终端品牌商合作关系发生变化，或客户经营状况出现变化，将会对公司销售收入产生不利影响。

2) 市场开拓不及预期的风险

由于电子胶粘剂对于终端产品的各项功能实现、可靠性、生产成本及效率均有关键性的影响，下游客户选择产品需要经过严苛的测试，因此倾向于与原有供应商长期合作。目前国内高性能电子胶粘剂市场主要由国外品牌主导，在公司扩展市场过程中，如果目标下游客户已有稳定供应商且更换供应商意愿较弱或国产化的意愿不足，将不利于公司开拓新客户。另一方面，公司重点拓展的新能源及半导体领域市场具有技术水平要求高的特点，若公司产品无法满足客户要求，将对公司未来业绩增长造成不利影响。

3) 原材料价格波动和供应风险

公司电子胶粘剂产品的主要原材料包括树脂、填料、助剂等，在电子胶粘剂的生产成本中占比较高，因此原材料价格波动将直接影响公司产品的生产成本。同时，高性能电子胶粘剂对于原材料的性能和质量要求较高，目前部分国产原材料的性能和质量与国外仍存在一定差距，因此公司部分主要原材料需采购境外品牌产品。如果未来相关原材料供应、国际贸易环境或进口政策发生不利变化，将增加公司原材料采购难度和成本，从而影响公司的产品生产和经营业绩。

(2) 技术及创新风险

1) 技术迭代、新产品研发风险

智能终端、新能源、半导体、通信等领域的终端产品迭代速度快，对电子胶粘剂的性能和品质不断提出新要求，不同下游应用领域的产品用胶点和功能需求存在较大差异，需要电子胶粘剂企业具有快速、高效的产品研发能力。若公司无法准确地把握下游行业的发展趋势并根据下游发展趋势进行研发创新，或者公司的技术储备无法满足客户生产应用场景需求，将导致公司无法及时研发并生产出与下游客户需求适配的产品，对公司的业务开拓和盈利能力将造成不利影响。

2) 研发人员流失风险

电子专用高分子材料行业是人才密集型行业。电子胶粘剂产品的研发是基于实验数据不断进行配方调试的过程,研发人员需要具备深刻的学科知识理解和丰富的行业应用经验。截至 2025 年末,公司有研发人员 120 人,占当期末员工总数比例 26.03%,优质且稳定的研发人员对公司生产经营具有重要作用。如未来公司薪酬水平与同行业竞争对手相比失去竞争优势,或内部晋升、激励制度得不到有效执行,可能导致研发人员的流失,从而影响公司的新产品开发进度,并对公司经营产生不利影响。

3) 核心技术泄漏风险

电子专用高分子材料行业是技术密集型行业。电子胶粘剂产品的核心技术是配方以及关键的生产工艺参数,配方设计直接影响到产品的性能、成本以及公司的市场竞争力。当前公司有多项技术和产品处于在研阶段,核心技术保密对于公司尤为重要。如果未来公司在经营过程中因技术信息保管不善、技术人员流失、个别员工工作疏忽或违规操作等导致核心技术泄密,将对公司发展产生不利影响。

(3) 财务风险

1) 毛利率下降的风险

公司凭借对化学材料的理解、应用经验积累及持续创新能力,使得公司产品保持较高的毛利率水平。报告期内,公司主营业务毛利率分别为 77.29%、74.74% 和 77.06%。但若未来出现市场竞争进一步加剧、公司新产品开发和迭代速度放缓、产品价格及原材料采购价格发生重大不利变化、上下游行业供需情况发生重大不利变化、与客户价格条款发生重大不利变化等负面情形,则公司毛利率存在下降的风险,将对公司的经营业绩造成不利影响。

2) 固定资产折旧及减值风险

报告期各期末,公司固定资产账面价值分别为 13,756.95 万元、28,187.14 万元和 34,543.90 万元,占总资产的比例分别为 13.61%、24.41%及 26.38%;公司在建工程账面价值分别为 13,044.17 万元、9,541.65 万元和 11,751.37 万元,占总资产的比例分别为 12.90%、8.26%及 8.98%。随着公司募投项目相关在建工程转入固定资产,新增机器设备等固定资产投入使用后将相应增加折旧费用。若相关

产能释放、产品销售或经营效益未达预期，新增折旧费用将对公司盈利水平产生不利影响。同时，若固定资产实际使用情况或预计可收回金额低于账面价值，公司存在对相关固定资产计提减值准备的风险，从而对公司的利润造成不利影响。

3) 应收账款无法收回的风险

报告期各期末，公司应收账款的账面价值分别为 14,750.80 万元、14,513.88 万元和 15,410.22 万元，占各期末流动资产的比例为 26.74%、27.98%及 24.56%。虽然公司客户主要系境内外上市公司及其子公司，资信和回款能力良好，但随着公司营业收入规模的不断提高、新应用场景的进一步拓展，公司客户数量及应收账款余额或将持续增长，如果部分客户支付能力不及预期，出现拖延付款等现象，公司将面临无法及时收回货款的风险。

4) 商誉减值风险

报告期内，公司于 2023 年对子公司深圳美科泰和上海锐朗分别计提商誉减值 2,683.45 万元和 331.23 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司商誉为 648.95 万元，如果后续宏观经济环境或下游行业出现趋势性下降，被收购公司未来运营和盈利状况未达预期，则公司商誉可能面临继续减值的风险。

5) 存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 2,619.36 万元、3,003.00 万元及 3,284.11 万元，占各期末流动资产比重分别为 4.75%、5.79%和 5.23%。存货账面价值整体呈上升趋势，主要因为公司生产经营规模的提升，公司加大生产备货所致。报告期内，公司已按照存货成本与可变现净值孰低原则计提了相应的存货跌价准备。未来，如果因客户或市场需求变动，公司不能及时消化现有库存或主要产品的价格出现下滑，可能导致存货出现滞销以及减值的风险，将对公司的现金流与财务状况造成不利影响。

6) 汇率波动风险

公司采购及销售活动均存在使用美元、欧元、韩元和日元等外币交易的情形，导致因汇率波动产生的汇兑损益。报告期各期，公司汇兑损益分别为-118.67 万元、-15.60 万元和 126.10 万元，虽然对公司业绩影响较小，但随着公司生产经营规模的扩大，其影响规模可能呈上升趋势。若未来人民币兑外币汇率波动幅度扩

大，可能导致公司产生金额较大的汇兑损益，进而影响公司利润。

7) 税收优惠政策变化的风险

公司为高新技术企业，享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。公司现行有效的高新技术企业证书将于 2027 年 12 月到期，若相关证书到期后，未能被重新认定为高新技术企业，或国家关于高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。

(4) 法律风险

目前，公司部分租赁房屋的出租方因历史原因未办理租赁房屋的产权证书，部分租赁房屋因出租方等原因未能办理租赁备案。若公司后续无法继续租赁前述房屋，则会对公司生产经营的稳定性产生不利影响。

2、与行业相关的风险

(1) 下游行业竞争加剧的风险

公司电子胶粘剂主要应用于智能终端、新能源、半导体、通信等领域，受下游行业景气度影响较大。在智能终端领域，随着下游市场竞争加剧，客户对材料性能与价格竞争力提出更高标准，可能导致公司面临产品价格下行与毛利空间收窄的压力。在新能源领域，随着新能源汽车与可再生能源行业步入规模化发展阶段，竞争强度持续提升，可能影响电子胶粘剂产品的整体定价水平。在半导体领域，尽管当前电子胶粘剂国产化率仍较低、替代空间较大，但随着更多国内企业切入该赛道，以及国际龙头企业为维护市场份额采取更具竞争性的策略，若公司无法在技术性能、稳定性与综合成本方面持续保持优势，可能面临市场份额拓展不及预期的风险。综上，若电子胶粘剂下游主要应用行业竞争加剧，将对公司的经营业绩及持续成长能力产生不利影响。

3、其他风险

(1) 发行失败风险

公司本次申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，发行结果将受到证券市场整体情况、国内外宏观经济环境、公司发展前景、投资者对本次发行方案的认可程度及股票价格未来趋势判断等多种因素的影响，可能存在因投资者认购不足而导致发行失败的风险。

(2) 募集资金投资项目实施及新增产能不能被有效消化的风险

公司本次募集资金拟投资于“德聚高端复合功能材料生产项目”“德聚北方总部产研一体化项目”“东莞研发中心及信息化项目”“营销服务及技术支持中心建设项目”等。这些项目的可行性是基于当前市场环境和行业发展趋势的判断。在项目实施过程中，可能面临因宏观经济变化、产业政策调整、市场竞争加剧等因素导致的项目延期或投资回报不及预期的风险。项目建成后，公司的产能将大幅提升，固定资产规模及折旧费用亦将相应增加。如果届时市场需求增长不及预期，或公司市场开拓不力，新增产能将面临无法被有效消化的风险，从而对公司的经营成果和盈利能力产生不利影响。

二、发行人本次发行情况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不超过 24,469,000 股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 24,469,000 股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 97,876,000 股		
每股发行价格	【】 元/股		
发行市盈率	【】 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】 元/股	发行前每股收益	【】 元/股
发行后每股净资产	【】 元/股	发行后每股收益	【】 元/股
发行市净率	【】 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，每股净资产按截至报告期末经审计的归属于母公司股东的权益与募集		

	资金净额之和除以发行后总股本计算)
发行方式	网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他方式，包括但不限于向战略投资者配售股票
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止的认购者除外），或中国证监会、深圳证券交易所规定的其他对象
承销方式	余额包销
拟公开发售股份股东名称	不适用
发行费用的分摊原则	不适用
募集资金总额	【】万元
募集资金净额	【】万元
募集资金投资项目	德聚高端复合功能材料生产项目
	德聚北方总部产研一体化项目
	东莞研发中心及信息化项目
	营销服务及技术支持中心建设项目
	补充流动资金
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，包括：保荐及承销费【】万元、律师费用【】万元、审计及验资费用【】万元、发行手续费用及其他【】万元
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	【】
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	【】
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）	不适用
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）本次证券发行的保荐代表人

中信证券指定吴恢宇、刘坚担任本次发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

吴恢宇先生，任投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，通过国家法律职业资格考试，曾负责或参与天德钰 IPO、宏工科技 IPO、拓尔微 IPO、国信证券 IPO，日发精机、TCL 科技、实益达、美尚生态、瀚蓝环境等发行股份购买资产项目，工业富联收购鼎捷软件、南昌光谷收购长方集团、勤诚达收购亿晶光电、天健集团控股权转让等上市公司收购项目，金奥博、硕贝德、武钢股份、湖北能源等非公开项目、东江环保绿色公司债等再融资项目。吴恢宇先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

刘坚先生，任投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，注册会计师，作为项目成员或负责人负责或参与的项目包括本川智能 IPO、宏工科技 IPO、金奥博非公开发行、硕贝德非公开发行、富满微非公开发行、振德医疗可转债、TCL 科技重大资产重组等项目。刘坚先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为黄耀文，其保荐业务执行情况如下：

黄耀文先生，任投资银行管理委员会副总裁，注册会计师，曾负责或参与宏工科技 IPO 项目、日发精机重大资产重组等项目。黄耀文先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）本次证券发行项目组其他成员

项目组其他成员：钟凌飞、欧龙、丁潮钦、琚鹏飞、胡正江、刘澍宇、叶之秋、罗祺辉、胡海洋。上述人员最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。

四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书出具日，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方

未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书出具日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况

截至本上市保荐书出具日，保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份的情况，亦不存在在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书出具日，发行人及发行人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方存在相互提供担保或者融资等情形。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本上市保荐书出具日，保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见

（一）保荐人关于本项目的内部审核程序

中信证券根据《证券公司内部控制指引》（中国证监会证监机构字[2003]260号）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第207号）以及《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》（发行监管函[2013]346号）等有关法律法规和规范性文件的要求，制定《投资银行管理委员会项目开发和立项管理办法》《投资银行管理委员会股权承销与保荐项目尽职调查工作管理办法》《投资银行管理委员会质量控制工作管理办法》《投资银行管理委员会项目管理办法》等相关规定。根据规定，中信证券内部项目审核流程主

要包括如下环节：

1、立项审核

中信证券投资银行管理委员会（以下简称“投行委”）下设项目立项委员会，立项委员会由投行委各部门、公司其他相关部门（内核部等）相关人员组成。

项目组按照投行委的相关规定完成立项文件，经项目所属投行部门行政负责人同意后，向投行委质量控制组（以下简称“质控组”）正式提交立项申请材料。

质控组对立项申请文件进行全面审核，并提出审核意见。质控组在立项申请文件审核通过后组织召开立项会。

保荐项目立项会由 7 名委员参加，实际参会委员人数（包括现场和电话）不少于 5 人（含 5 人），且其中内控部门委员不低于 1/3 即可召开会议。立项委员会的表决实行一人一票，项目须经委员 5 票以上（含 5 票）同意方能通过立项。

2、内核流程

中信证券设内核部，负责本机构投资银行类业务的内核工作。内核部作为公司投资银行类业务第三道防线内控部门之一，与第三道防线其他内控部门，通过介入主要业务环节、把控关键风险节点，实现公司层面对投资银行类业务风险的整体管控。中信证券保荐类项目内核流程具体情况如下：

（1）现场内核

内核部将按照保荐项目所处阶段以及项目组的预约情况对项目进行现场内核，内核部将指派审核员通过现场了解发行人的生产经营状况、复核尽调过程中的重点问题、抽查项目组工作底稿、访谈发行人高管等方式进行现场内核工作。

（2）申请内核

项目组向内核部报送内核材料后，内核部将按照内核工作流程及相关规定对申报材料的齐备性、完整性和有效性进行核对。对不符合要求的申报材料，内核部将要求项目组按照内核规定补充或更换材料直至满足申报要求。

（3）项目初审

内核部在受理项目申报材料之后，将指派审核员分别从法律和财务角度对项

目申请文件进行初审。同时内核部结合项目情况，有可能聘请外部律师和会计师等专业人士对项目申请文件进行审核，为本机构内核部提供专业意见支持。如有需要，还会征求本机构合规部、研究部、资本市场部相关意见。

(4) 问核程序

由内核部审核员召集该项目的签字保荐代表人、项目负责人履行问核程序，询问该项目的尽职调查工作情况，并提醒其未尽到勤勉尽责的法律后果。问核内容围绕尽职调查等执业过程和质量控制等内部控制过程中发现的风险和问题开展，问核情况会形成书面或者电子文件记录，由问核人员和被问核人员确认，并提交内核会议。

(5) 内核会审议

内核审议在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上，结合项目质量控制报告，重点关注审议项目是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职调查是否勤勉尽责。发现审议项目存在问题和风险的，提出书面反馈意见，内核会召开前由内核部汇总出具项目内核报告。

内核会议主要包括：项目组对项目的基本情况简要介绍；项目组对项目内核报告涉及问题的形成原因、目前现状及落实解决情况进行解释和说明，提供最新资料（如有），并回答参会内核委员的提问，对尚待核实情况或尚待提供资料进行记录。会议期间，参会委员可就项目相关事项提出问题并发表个人见解。

内核委员会以现场会议方式履行职责，以投票表决方式对内核会议审议事项作出审议。同意对外提交、报送、出具或披露材料和文件的决议应当至少经 2/3 以上的参会内核委员表决通过。项目内核表决票有三类意见供内核委员进行选择：无条件同意、有条件同意、反对。除选择无条件同意外，内核委员均应在表决票中注明理由。

内核会议结束后，除无条件通过内核会审议外，内核部审核员应汇总参会内核委员意见以及内核会讨论情况形成内核会决议及反馈意见，内核会决议发出前需经参会内核委员确认。内核机构对内核意见的答复、落实情况进行审核，确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露前得到落实。

（6）外部审核期间

反馈意见回复报告、上市委意见回复报告、举报信核查报告、会后事项专业意见、补充披露等材料 and 文件对外提交、报送、出具或披露前，均需履行用印签报流程并经内核部书面审核。

（二）保荐人关于本项目的内核意见

2026年5月29日，在中信证券大厦召开了广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目内核会，内核委员会对该项目申请进行了讨论，经全体参会内核委员投票表决，该项目通过了中信证券内核委员会的审议，同意将广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目申请文件对外申报。

六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项

保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会的规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，对发行人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐德聚技术本次首次公开发行股票并上市，并据此出具本上市保荐书。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会规定的其他事项。

中信证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深交所对推荐证券上市的规定，自愿接受深交所的自律监管。

七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明

2026年4月10日，发行人召开第二届董事会第二次会议，发行人全体董事出席了本次会议，发行人高级管理人员列席了本次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》等议案。

2026年4月28日，发行人召开2026年第三次临时股东会，出席本次股东会的股东及股东代表共42名，代表股份7,340.70万股，占发行人总股本的100%，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》等议案。

综上所述，保荐人认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

八、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的说明

（一）公司符合创业板行业领域

公司专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售，主要为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案，产品主要应用于智能终端、新能源、半导体、通信等领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为电子专用材料制造（C3985）。根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司产品所属的电子专用材料制造及相关电子级化学品和材料列入“3 新材料产业”之“3.3 先进石化化工新材料”之“3.3.6 专用化学品及材料制造”。

公司所处行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的行业，不属于产能过剩行业或《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的淘汰类行业，亦不属于学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。

（二）公司符合创业板定位相关指标要求

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》的规定，“本所支持和鼓励符合下列标准之一的成长型创新创业企业申报在创业板发行上市：

- 1、最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年投入金额不低于 1,000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 25%；
- 2、最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 25%；
- 3、属于制造业优化升级、现代服务业或者数字经济等现代产业体系领域，且最近三年营业收入复合增长率不低于 30%。

最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。”

公司符合上述第二款创业板定位相关指标要求，具体如下：

指标内容	是否符合	公司具体实现情况
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	☒ 是 ☐ 否	公司最近三年累计研发费用金额为 19,688.33 万元
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%	不适用	2025 年, 公司营业收入为 4.58 亿元, 大于 3 亿元, 不适用营业收入复合增长率要求
最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求	☒ 是 ☐ 否	

综上所述，公司符合创业板定位相关指标要求。

（三）公司自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

1、公司围绕原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化构建了“协同联动、交替迭代”的研发体系

电子胶粘剂属于典型的配方型、应用型功能材料，其性能取决于从原材料开发与修饰到生产工艺的多环节协同。公司围绕原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化构建了“协同联动、交替迭代”的研发体系，实现从底层材料到终端应用的系统性研发能力闭环。

在原材料开发与修饰方面，公司围绕下游客户对产品连接、防护、导热散热、导电绝缘、应力缓冲等性能要求，通过定制合成、分子结构设计、原材料修饰等方式提升基础材料性能，进而拓展通用材料在电子制造场景中的应用边界，为差异化产品开发构建底层原材料基础。

在产品配方设计方面，公司依托丙烯酸酯、环氧树脂、有机硅、聚氨酯、改性硅烷、杂化等六大化学体系积累，围绕客户具体用胶点，对树脂、填料、助剂等多元材料进行高效复配与动态优化，在粘接强度、模量、热膨胀系数、导热性、绝缘性、耐湿热性、工艺适配性等多性能约束下实现平衡。公司的配方设计能力建立在对客户潜在需求、产品结构、可靠性要求与具体应用场景的深度理解之上，而这一能力离不开与核心客户长期稳定的合作关系。公司凭借长期的技术积累切入客户关键项目并持续获取应用反馈，在样品开发、可靠性验证、产线适配和量产验证的反复迭代过程中形成高频互动与正反馈机制，进而又反哺公司的技术积累、需求洞察、方案适配和产品迭代，构筑“技术突破—客户绑定—能力迭代”的良好体系。

在生产工艺优化方面，公司在流体力学和多相体系共混的理论基础上，围绕材料改性、体系兼容性转变、液-液混合、固-液混合、分散、脱除空气以及非必要小分子、精确分装、检测等关键环节进行工艺控制与持续优化，使材料体系和配方设计能够转化为符合客户量产要求的产品。同时，公司产品导入需经过样品开发、客户测试、可靠性验证、小批量试用及量产验证等环节，进一步体现电子胶粘剂产品较高的技术门槛与客户认证壁垒。

依托上述“协同联动、交替迭代”的研发体系，公司有能力与全球头部客户深度协同，能够将客户应用需求、底层材料开发、配方设计和生产工艺持续联动，为公司在智能终端、新能源、半导体及通信等领域持续推出高性能电子胶粘剂产品提供研发与创新能力支撑。

2、公司以产品创新推动电子制造关键环节升级，体现新旧产业融合特征

电子胶粘剂是实现电子元器件连接的关键功能性材料。随着下游智能终端、新能源、半导体及通信等领域终端产品的迭代发展，高性能电子胶粘剂在多个制造环节中发挥着替代传统工艺、提升产品可靠性和优化生产效率的重要作用。公司将高分子材料技术与制造工艺深度结合，相关产品嵌入下游客户产品设计、生产工艺等过程，助力电子制造向高精度、高可靠性和材料功能复合化方向升级，推动核心技术在电子制造环节实现产业化应用。

在智能终端领域，随着下游产品向轻薄化、柔性化、多功能化等方向发展，FPC、PCBA 及功能模组等核心器件对电子胶粘剂的性能、可靠性及工艺适配性提出更高要求。针对客户提出的“无丙烯酸致敏物”及“FPC 阴影区完全固化”等严苛要求，公司在兼顾多项性能指标的前提下，通过自主研发的 UV-湿气双重固化技术，开发出兼具快速固化、高粘接强度与优异柔韧性的元器件包封胶产品，系统性提升了耐化学性、生物相容性与可靠性，已成为相关产业链中的核心材料。在核心组件粘接环节，公司开发的耐高温粘接材料有效解决了传统粘接胶在无铅回流焊高温制程中普遍存在性能衰减、多基材浸润性差等问题，支撑了下游产品的高精度组装需求。

在新能源领域，围绕新能源汽车对高可靠、轻量化的核心需求，公司通过产品创新推动客户传统工艺制程革新，以性能更优的材料方案替代传统工艺方案，提升客户生产效率与产品可靠性。例如，公司通过引入络合技术，对高分子链进行自主改性，实现环氧低温快速凝胶，以胶接工艺革新传统焊接方案，已成功导入国际领先电动汽车供应链并成为关键材料。

在半导体领域，为适配半导体产业向高功率、高热密度、高可靠性发展的技术需求，公司开发出高效导热的导热界面材料。该产品达到 UL94 V-0 级无卤阻燃的高标准，在相关应用场景中成功替代传统“导热凝胶+机械固定”的分体方

案，有效降低热阻并提升器件运行可靠性。

在通信领域，针对 5G 基站、数据中心等通信设备的电磁屏蔽需求，公司研制出具有低硬度、高屏蔽效能的点胶成型屏蔽导电胶。该产品依托公司自主开发的低硬度点胶成型屏蔽导电胶核心技术，解决了传统电磁屏蔽材料装配压缩力过高和屏蔽性能衰减的痛点，满足轻质复杂结构器件的特殊装配要求，以及在极端环境下长期可靠屏蔽性的要求。

3、公司以技术成果实现产业化转化，创新成果形成规模化经营贡献

公司始终重视技术研发和技术成果产业化，截至 2025 年末拥有 120 人的研发团队，占员工总数比例为 26.03%。报告期内，公司研发费用分别为 5,952.94 万元、6,936.12 万元和 6,799.27 万元，占营业收入的比例分别为 16.94%、18.02% 及 14.85%。截至本上市保荐书出具日，公司已获发明专利授权 65 项、实用新型专利授权 49 项，公司荣膺工业和信息化部新一轮第一批国家重点“小巨人”企业及第三批专精特新“小巨人”企业，经广东省科学技术厅认定为“广东省新型高端电子胶粘剂（德聚）工程技术研究中心”，经广东省工业和信息化厅认定为“第 22 批省级企业技术中心”和“2024 年广东省省级制造业单项冠军企业-丙烯酸电子胶粘剂”。

公司创新成果已形成规模化经营贡献。报告期内，公司自产电子胶粘剂收入分别为 31,851.90 万元、36,308.20 万元和 43,787.91 万元，持续增长。公司经营成果主要来源于自主研发、自主生产的电子胶粘剂产品，已通过客户导入和规模化应用将核心技术转化为主营业务收入。

（四）公司的成长性及其表征

报告期内，公司主营业务收入分别为 35,075.78 万元、38,438.74 万元、45,696.55 万元，扣非后归属母公司股东的净利润分别为 4,335.45 万元、7,724.90 万元及 12,457.28 万元，业务规模和盈利能力持续提升。

从现有业务基础看，公司已形成以智能终端、新能源、半导体、通信等领域协同拓展的产品和客户结构。公司主要向东山精密、鹏鼎控股、立讯精密、安费诺、旗胜电子、Sanmina、台郡科技、和硕、富士康等全球知名电子制造厂商直接供货，产品最终应用于苹果、特斯拉、OPPO、华为、阳光电源、比亚迪、vivo、

小米、三星、宁德时代等知名终端品牌商或其产业链客户，形成了覆盖智能终端、新能源、半导体、通信等领域的规模化应用能力。由于电子胶粘剂产品需经过客户样品开发、可靠性验证、产线适配、小批量试用及量产验证等环节，客户导入周期较长，一旦进入客户供应体系并实现稳定供货，通常具备较强的客户粘性和持续迭代空间，为公司成熟产品持续放量、现有客户体系内拓展新产品和新用胶点提供了重要支撑。

从产品延展能力看，公司依托原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化“协同联动、交替迭代”的研发体系，已在多个应用场景中形成代表性产品成果。公司原创开发的柔性电路板（FPC）用元器件包封胶已实现规模化应用；自主研发的磁芯粘接胶已导入国际领先电动汽车供应链并成为关键材料，报告期内相关产品收入实现较快增长；在半导体领域，公司亦是国内少数实现芯片级底部填充胶在倒装芯片（Flip Chip）封装等先进封装工艺中产业化应用的厂商。上述代表性产品从智能终端、新能源汽车到芯片封装场景逐步延展，形成了沿技术门槛、可靠性要求和产品附加值持续提升的纵向应用布局。

从未来增长储备看，随着终端产品迭代、先进封装自主配套加速及新兴算力基础设施建设等需求提升，下游客户对高可靠性粘接、导热、密封、电气连接和功能防护材料的需求不断增加。公司已有多项新产品实现出货或进入客户导入后的爬坡放量阶段，包括 AI 电源粘接导热胶、光模块密封胶、导电银胶、AR 眼镜结构粘接胶、电池组粘接保护胶等，相关产品对应的客户或终端品牌商均为行业知名企业。公司将积极把握上述新兴应用带来的功能性材料需求提升机遇，在现有应用领域内，持续推动公司技术储备和客户验证成果逐步转化为规模化收入贡献，围绕新终端形态、新产品结构、新用胶点和更高可靠性要求进行横向延展。

综上所述，公司依靠核心技术开展生产经营，主营业务突出，业务规模持续增长，公司主营业务属于新产业、新业态、新模式；公司不属于原则上不支持申报在创业板发行上市的行业范围内，公司具备创新、创造、创意特征，具有良好的成长性和较强的自主创新能力，符合《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》等法律、法规或规范性文件对创业板定位的要求。

九、保荐人关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》上市条件的说明

保荐人对发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》规定的上市条件进行了逐项核查。经核查，保荐人认为本次证券上市符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》规定的上市条件，具体情况如下：

1、符合中国证监会规定的创业板发行条件

发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》2.1.1 条第一款第一项的规定，参见本上市保荐书之“八、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的说明”相关内容。

2、发行后股本总额不低于 3,000 万元

本次公开发行后股本总额为不超过人民币 97,876,000 元，不低于人民币 3,000 万元，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》2.1.1 条第一款第二项的规定。

3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上

本次公开发行股票不超过 24,469,000 股，占发行后总股本的 25%以上，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》2.1.1 条第一款第三项的规定。

4、财务指标符合《上市规则》规定的标准

发行人作为境内企业且不存在表决权差异安排，选择《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》2.1.2 第（一）款的上市标准“最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元”。发行人 2024 年度和 2025 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 7,164.96 万元和 12,457.28 万元，满足所选择的上市标准。

十、持续督导期间的工作安排

事项	工作安排
(一) 持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关制度；通过《保荐协议》约定确保保荐人对发行人关联交易事项的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定执行，对重大的关联交易保荐人将按照公平、独立的原则发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人按照《募集资金管理制度》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》、《对外担保管理制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查
(二) 保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐人有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、深圳证券交易所报告；按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐人履行保荐工作，为保荐人的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据
(四) 其他安排	无

十一、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式

保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司
保荐代表人	吴恢宇、刘坚
联系地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系电话	0755-23835458

十二、保荐人关于本项目的推荐结论

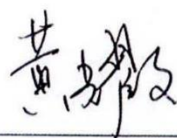
本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人认为，本次首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定；中信证券同意作为广东德聚技术股份有限公司本次首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

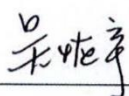
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

项目协办人签名：

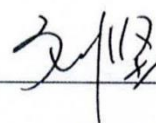


黄耀文

保荐代表人签名：



吴恢宇

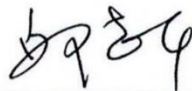


刘 坚



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

内核负责人签名：

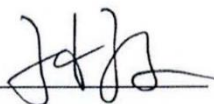


邱志千



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

保荐业务负责人签名：

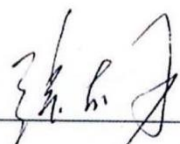


孙 毅



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

保荐机构董事长、法定代表人签名：_____



张佑君

